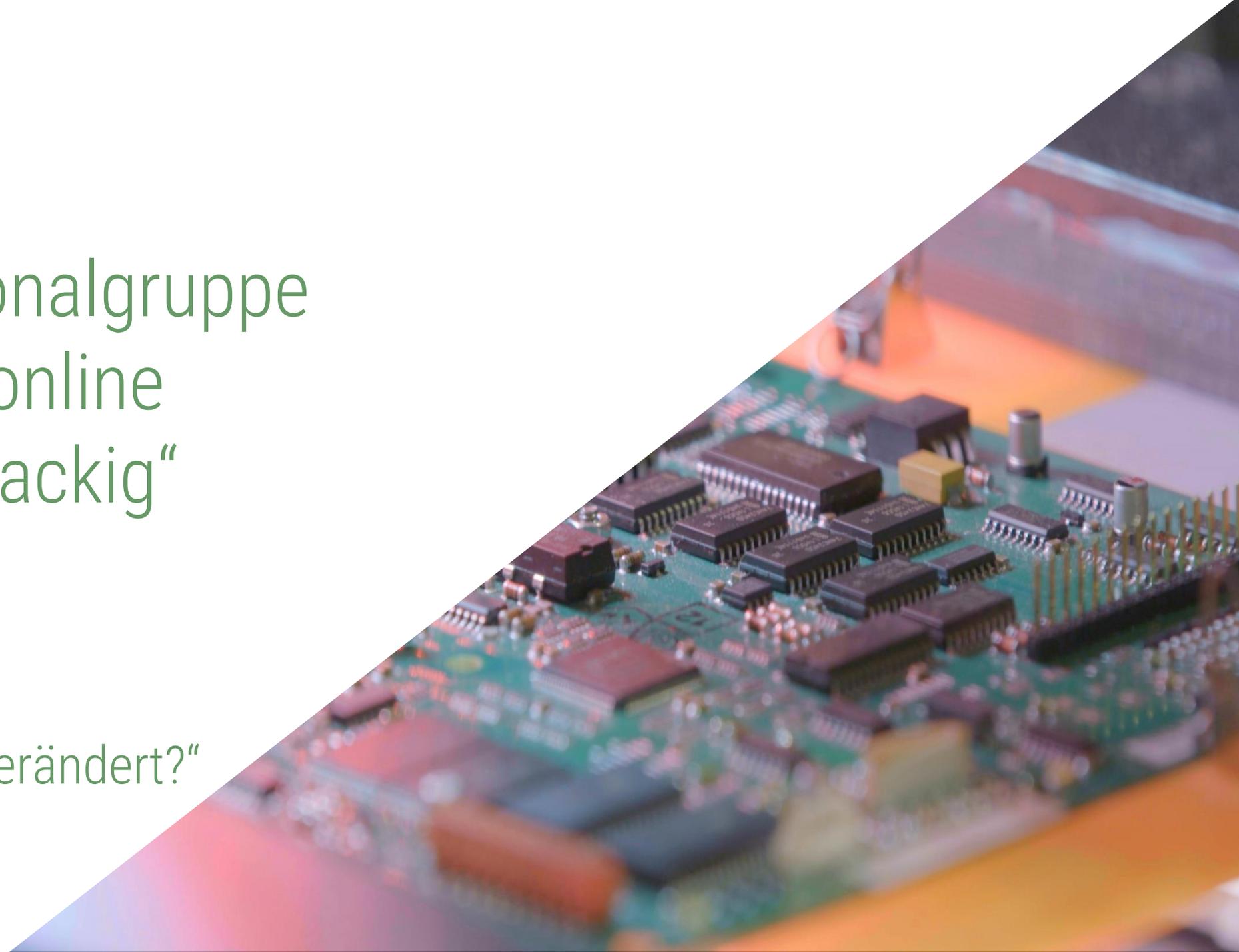


FED

Fachverband für Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

FED Regionalgruppe Stuttgart online „kurz & knackig“

Teil 2:
„IPC-4101E,
was hat sich verändert?“



Das heutige Team



Michael Matthes

Moderator
FED Regionalgruppenleitung
Stuttgart

michael.matthes@wittenstein.de



Roland Schönholz

Referent
Technisches Marketing,
Technolam GmbH
FED Regionalgruppenleitung
Stuttgart

roland.schoeholz@conselix.de



Yili Zhao

Organisation
Veranstaltungsmanagement
FED

y.zhao@fed.de

Die Idee

„kurz & knackig“ in der RG-Stuttgart

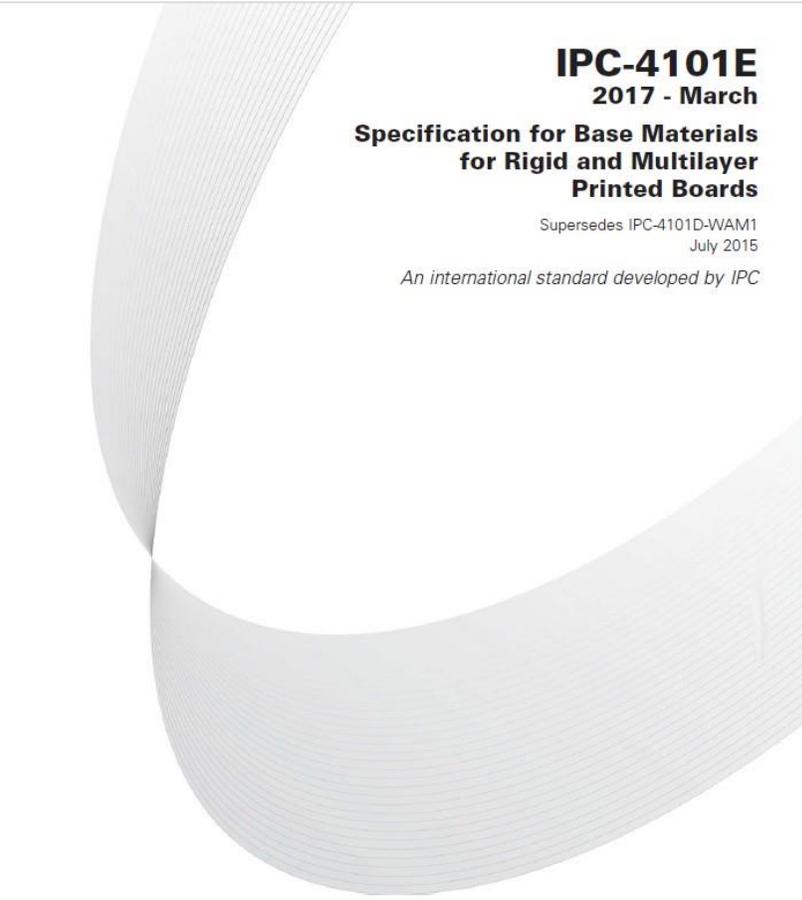
- kontinuierliche Pflege des Netzwerkes in Zeiten von Corona
- Versorgung der Mitglieder mit kurzen, aktuellen Infos
- Einbinden der Mitglieder in gemeinschaftliche Aktivitäten
- Verkleinerung der Distanz durch Online-Sessions
- Vergrößerung des Teilnehmer- und Referentenkreises

Kurze Einführung in GoToWebinar

- Stummschaltung der Teilnehmer
- Frage-Funktion während der Präsentation und Beantwortung der Fragen am Ende oder über Handhebe-Funktion just in Time und mit Audioübertragung
- Session wird aufgezeichnet
- Videoübertragung des Referenten und Moderators



Heutiges Webinar



IPC-4101E
2017 - March
**Specification for Base Materials
for Rigid and Multilayer
Printed Boards**
Supersedes IPC-4101D-WAM1
July 2015
An international standard developed by IPC

13.05.2020 16:00 Uhr

„IPC-4101E,

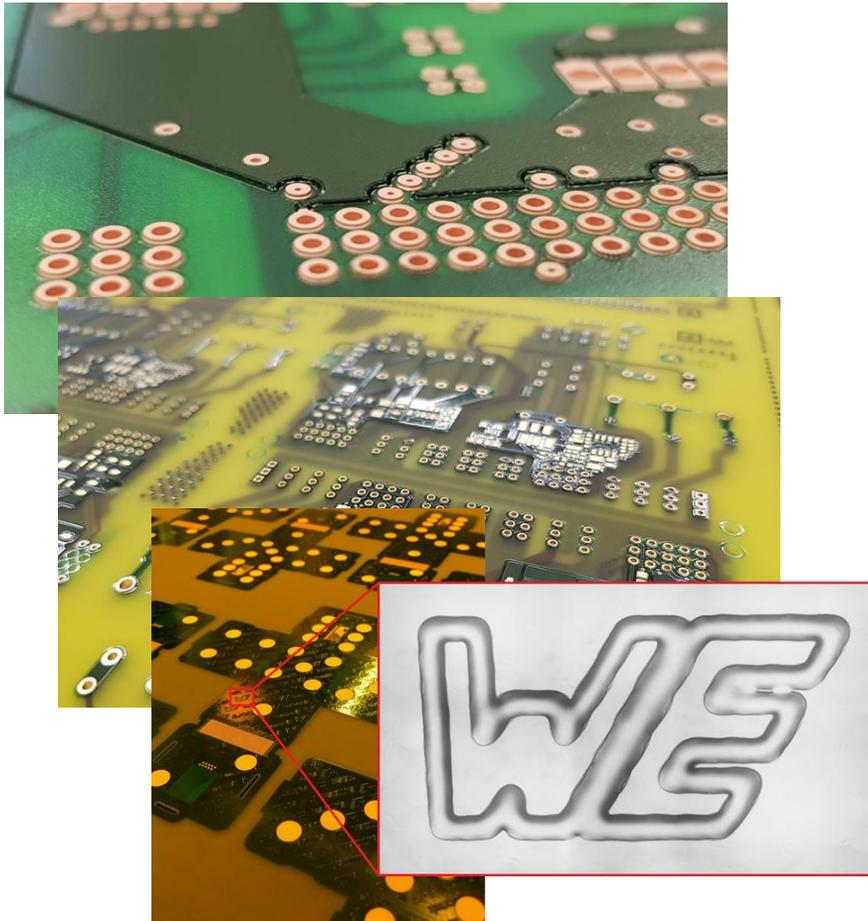
was hat sich verändert?“

**Referent: Roland Schönholz – Technisches Marketing,
Technolam GmbH**

Association Connecting Electronics Industries



Nächstes Webinar



03.06.2020 16:00 Uhr

„Überblick zur Lötstoppmaske in digitaler Additivtechnik bis hin zur funktionellen 3D- Oberfläche“

**Referent: Jürgen Wolf – Technischer Manager, Würth
Elektronik**

Übernächstes Webinar

FINE LINE
EXCELLENCE IN PCB

LEITERPLATTEN
KUPFER INLAY / COIN, KUPFER INSERT
TECHNOLOGIE

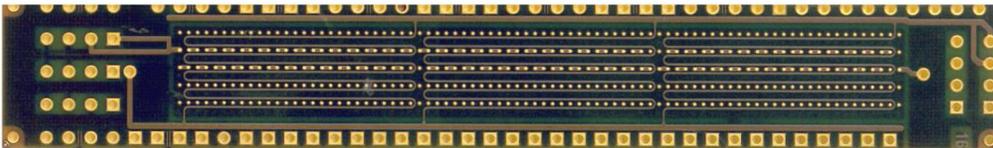
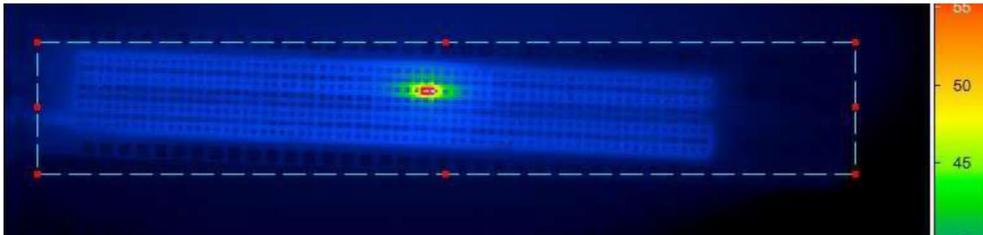
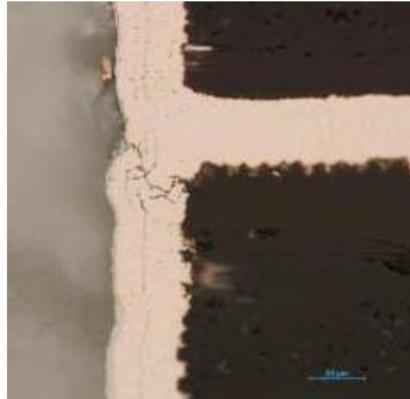
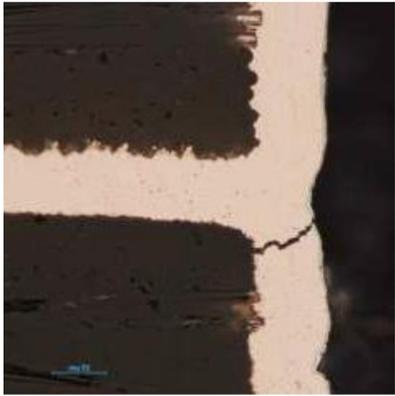
Albert Schweitzer
© Copyright Fine Line
Fine Line Gesellschaft
für Leiterplattentechnik mbH
Itterpark 4, D-40724 Hilden

24.06.2020 16:00 Uhr

**„ Leiterplatten Kupfer Inlay /
Coin, Kupfer Insert
Technologie“**

**Referent: Albert Schweitzer – Fine Line Gesellschaft für
Leiterplattentechnik mbH**

weitere Termine



15.07.2020 16:00 Uhr

**„Zuverlässigkeitsanalysen im
Bereich hochkomplexer
Leiterplatten“**

**Referent: Dr.-Ing. David Kurzmanowski
Würth Elektronik GmbH & Co. KG**

weitere Termine

- **Sommerpause**

und dann geht's weiter

- **23.09.2020 16:00 Uhr**

Thema und Referent steht noch nicht fest





Fachverband für Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Wir verbinden

FED e. V.
Frankfurter Allee 73C
10247 Berlin
Tel. +49(0)30340603050
info@fed.de
www.fed.de

